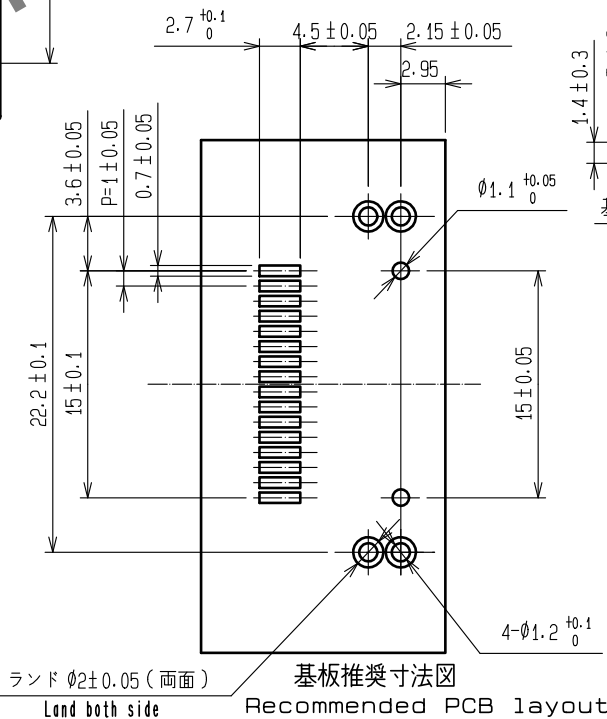
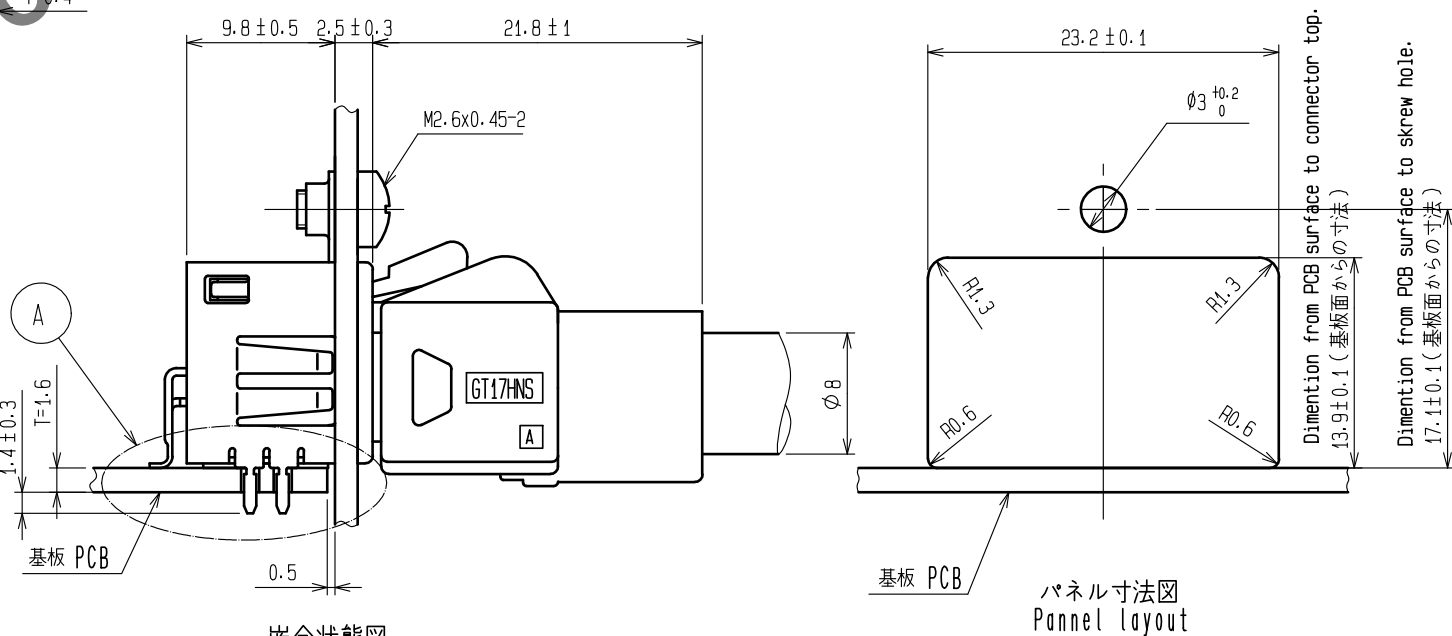




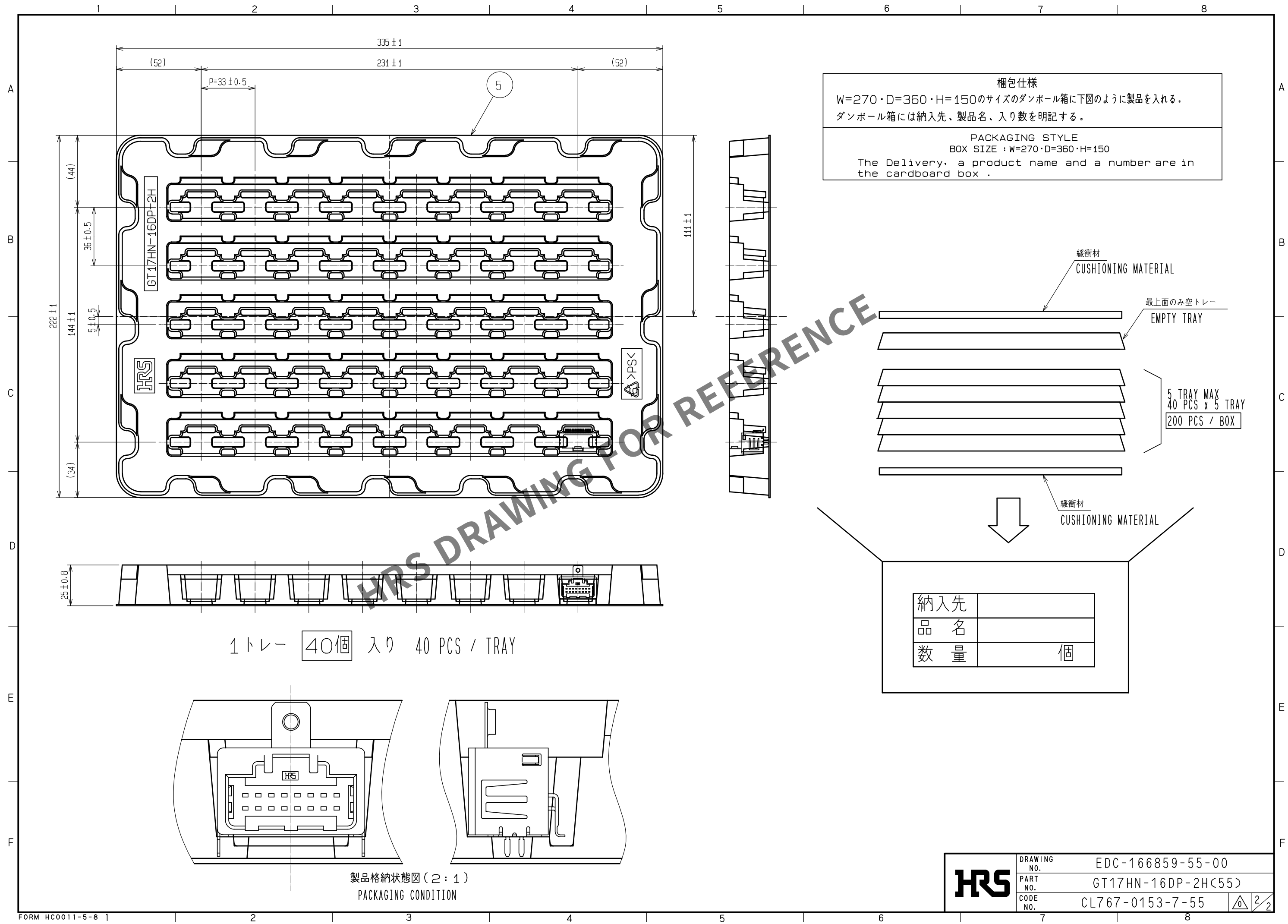
1. リフロー回数：2回。但し、2回目のリフローにおいては、一度、室温に戻すこと。
Note2. The temperature indicates the board surface temperature.
2. リフロー温度の測定は、コネクタリード部の基板表面温度を測定のこと。
Note3. Hand soldering: 280~300℃, 2s max.
3. 手半田温度：280~300℃、2S以内
Note4. Coplanarity: 0.1 max.
4. 端子平坦度：0.1以下
Note5. Recommended thickness of PCB: 1.6mm
5. 推奨基板厚：1.6mm



嵌合状態図
Mated connectors

FORM HC0011-5-7

May.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
In case of consideration for using Automotive equipment / device which demand high reliability, kindly contact our sales window correspondents.



納入先	
品 名	
数 量	個

HRS

DRAWING NO.	EDC-166859-55-00
PART NO.	GT17HN-16DP-2H(55)
CODE NO.	CL767-0153-7-55

2/2